

請求の範囲

- [請求項1] 基材層と、前記基材層の第1面側に設けられた粘着性樹脂層（A）と、前記基材層の第2面側に設けられ、かつ、外部刺激により粘着力が低下する粘着性樹脂層（B）と、を備え、前記粘着性樹脂層（A）の125℃における貯蔵弾性率 E' が $0.2 \times 10^6 \text{ Pa}$ 以上 $4.5 \times 10^6 \text{ Pa}$ 以下である粘着性フィルムと、前記粘着性フィルムの前記粘着性樹脂層（A）に貼り付けられた電子部品と、前記粘着性フィルムの前記粘着性樹脂層（B）に貼り付けられた支持基板と、を備える構造体を準備する工程（1）と、
- 封止材により前記電子部品を封止する工程（2）と、
- 外部刺激を与えることにより前記粘着性樹脂層（B）の粘着力を低下させて前記構造体から前記支持基板を剥離する工程（3）と、
- 前記電子部品から前記粘着性フィルムを剥離する工程（4）と、
- を少なくとも備える電子装置の製造方法。
- [請求項2] 請求項1に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記粘着性樹脂層（B）は150℃を超える温度で加熱することにより粘着力が低下する粘着性フィルムであり、工程（3）では150℃を超える温度に加熱する電子装置の製造方法。
- [請求項3] 請求項1または2に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記粘着性樹脂層（B）が気体発生成分および熱膨張性の微小球から選択される少なくとも一種を含む電子装置の製造方法。
- [請求項4] 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記粘着性樹脂層（A）は（メタ）アクリル系粘着性樹脂を含む電子装置の製造方法。
- [請求項5] 請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記封止材がエポキシ樹脂系封止材である電子装置の製造方法。